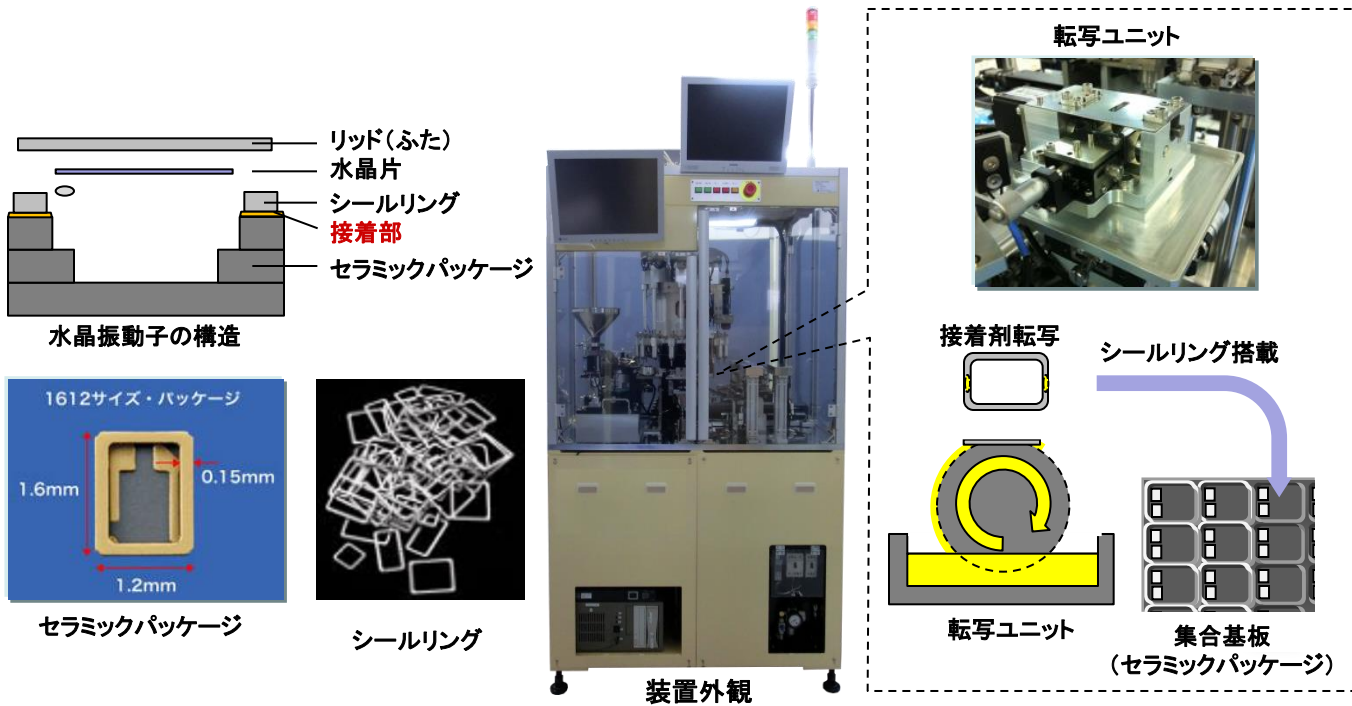


超小型セラミックパッケージ対応 シールリング接着搭載装置

【アキム株式会社】

【特 徴】

超小型サイズのセラミックパッケージ集合基板にシールリングを接着搭載する装置です。あらかじめ集合基板に接着剤を塗っておくのではなく、シールリングに適量の接着剤を転写し、直後に集合基板に搭載することで、高速化（0.35秒/個 ※従来の半分以下）と高精度化（搭載誤差±15ミクロン ※従来の半分以下）を実現しました。



【効 果】

- ① 高速化 ⇒ 生産コストの低減、設置スペース削減
- ② 高精度化 ⇒ 超小型部品（1.6×1.2mm以下）に対応
- ③ 接着品質向上 ⇒ 接着剤の適量塗布と乾燥時間の短縮化による
⇒ 精度UP、歩留り改善

スマートフォンやタブレットに数多く使用される超小型セラミックパッケージの製造工程において、最適な工法と、業界最高のコストパフォーマンスを提供します。



アキム株式会社

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-3-17

TEL: 049-288-4890 FAX: 049-288-4887 URL: <http://www.akim.co.jp/>

「第2回渋沢栄一ビジネス大賞」大賞受賞